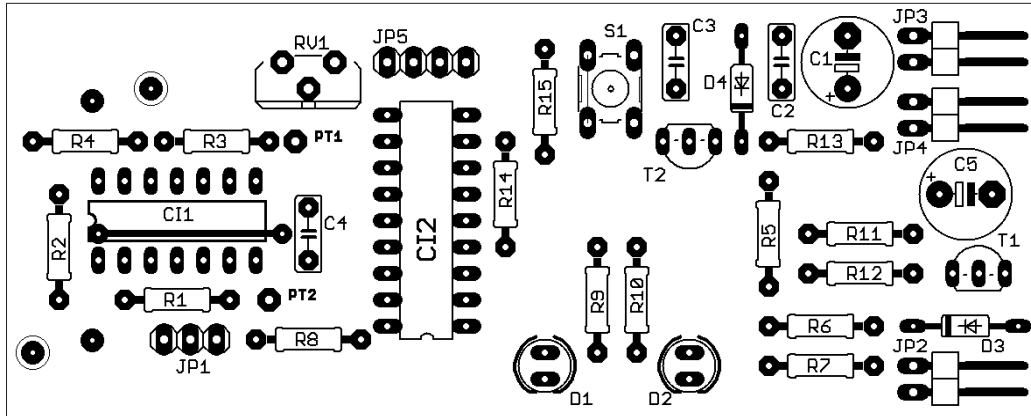


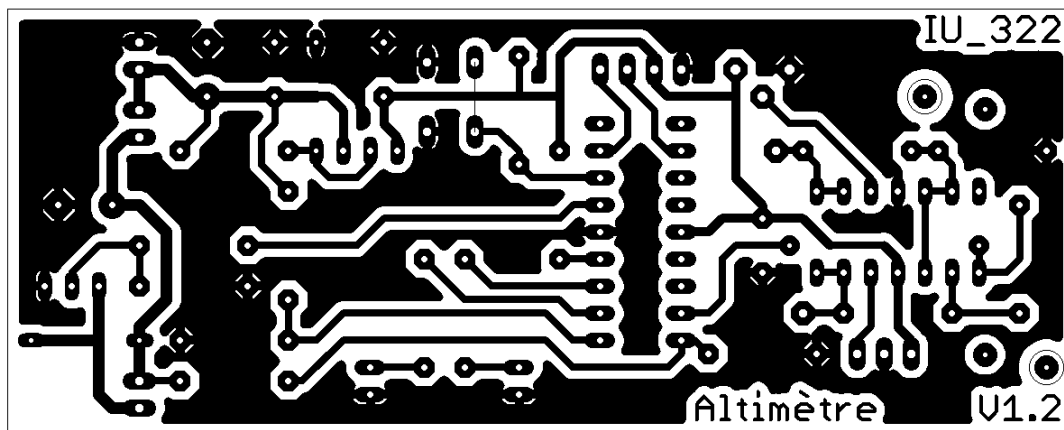
Fiche de fabrication

- Liste des opérations pour préparer le circuit imprimé à recevoir les composants.
- Ordre d'implantation des composants pour soudure.

Plan d'implantation



Coté soudure



Nomenclature

Composant	Valeur	Boitier	Notes
R1, R3, R9, R10, R13	1k Ω	1/4W	Marron, Noir, Rouge, Or
R2, R4	15k Ω	1/4W	Marron, Vert, Orange, Or
R5, R6	18k Ω	1/4W	Marron, Gris, Orange, Or
R7	39k Ω	1/4W	Orange, Blanc, Orange, Or
R8	12k Ω	1/4W	Marron, Rouge, Orange, Or
R14, R15	47k Ω	1/4W	Jaune, Violet, Orange, Or
R11	3,9k Ω	1/4W	Orange, Blanc, Rouge, Or
R12	10k Ω	1/4W	Marron, Noir, Orange, Or
RV1	47k Ω	ajustable	horizontal
C1	100 μ F/16V	Radial	
C2 à C4	100nF	Radial	
C5	220 μ F/25V	Radial	
CI1	MCP6042N	DIP-14	
CI2	PIC16F88	DIP-18	programmé

D1	Led Rouge	5mm	
D2	Led Verte	5mm	
D3	1N4148		
D4	BZX55C5V6		
JP1, JP3, JP4	Conn 1x02	Barrette sécable male coudée	
JP2	Conn 1x04	Barrette sécable male	
JP5	Conn 1x03	Barrette sécable CI	
S1	Bouton poussoir vertical		
T1, T2	2N2222	TO92	PN2222 (inversion du composant)
Divers	support	DIL-14	
	Support	DIL-18	

Détails de fabrication

Liste des opérations pour préparer le circuit imprimé à recevoir les composants.

1. Découper la carte aux dimensions
2. Percer tous les trous avec un foret de 0,8mm
3. Repercer les trous pour les composants JP2 à JP5 et D4 en 1mm
4. Et les trous pour les composants S1 et RV1 en 1,2mm
5. Repercer les 2 trous de fixation du capteur en 3,2mm

Ordre d'implantation des composants pour soudure.

Souder les composants de plus bas profil en premier:

1. le strap
2. les résistances
3. les deux diodes
4. les connecteurs JP3 à JP5
5. les supports de CI, JP1 et les points test
6. les condensateurs non polarisés
7. le bouton poussoir
8. les transistors
9. les leds et JP2
10. la résistance variable
11. les deux autres condensateurs